

YDS-B9MF-IMX377 V1.0

**12.35MP Sony IMX377 MIPI- und DVP-Parallelschnittstelle
M12-Kameramodul mit Festfokus**



Vorderansicht



Rückansicht

Spezifikationen

Kameramodul Nr.	YDS-B9MF-IMX377 V1.0
Auflösung	12.35MP
Bildsensor	IMX377
Sensorart	1/2.3"
Pixel Größe	1.55 um x 1.55 um
EFL	4.10 mm
F.NO	2.50
Pixel	4056 x 3046
Betrachtungswinkel	90.0°(DFOV) 77.0°(HFOV) 59.0°(VFOV)
Linseabmessungen	17.20 x 17.20 x 26.80 mm
Modulgröße	42.09 x 24.20 mm
Modultyp	Fester Fokus
Schnittstelle	MIPI und DVP-Parallel
Autofokus-VCM-Treiber-IC	Keiner
Objektivtyp	650 nm IR-Schnitt
Betriebstemperatur	-10°C to +70°C
Gegenstecker	AXE540124

YDS-B9MF-IMX377 V1.0

**12.35MP Sony IMX377 MIPI- und DVP-Parallelschnittstelle
M12-Kameramodul mit Festfokus**



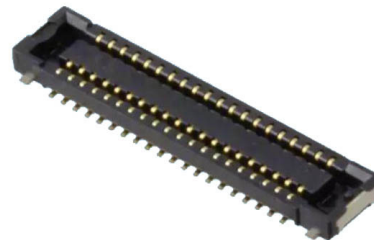
Ansicht von oben



Seitenansicht



Untersicht



Gegenstecker

ROHS

PIN SIGNAL

1	RESET
2	PWMON
3	DGND
4	MDP0/D0
5	MDN0/D1
6	DGND
7	MDP1/D2
8	MDN1/D3
9	DGND
10	MDP2/D6
11	MDN2/D7
12	DGND
13	MDP3/D8
14	MDN3/D9
15	DGND
16	MCP/D4
17	MCN/D5
18	PWMON2
19	SCL-2
20	AREF
21	VSYNC
22	SDA-2
23	PCLK
24	NC
25	SCL
26	SDA
27	DGND
28	MCLK
29	DVDD1.2V
30	DVDD1.8V
31	DGND
32	AVDD2.8V
33	AGND
34	DGND
35	NC
36	NC
37	NC
38	NC
39	DGND
40	DGND

Parameters:

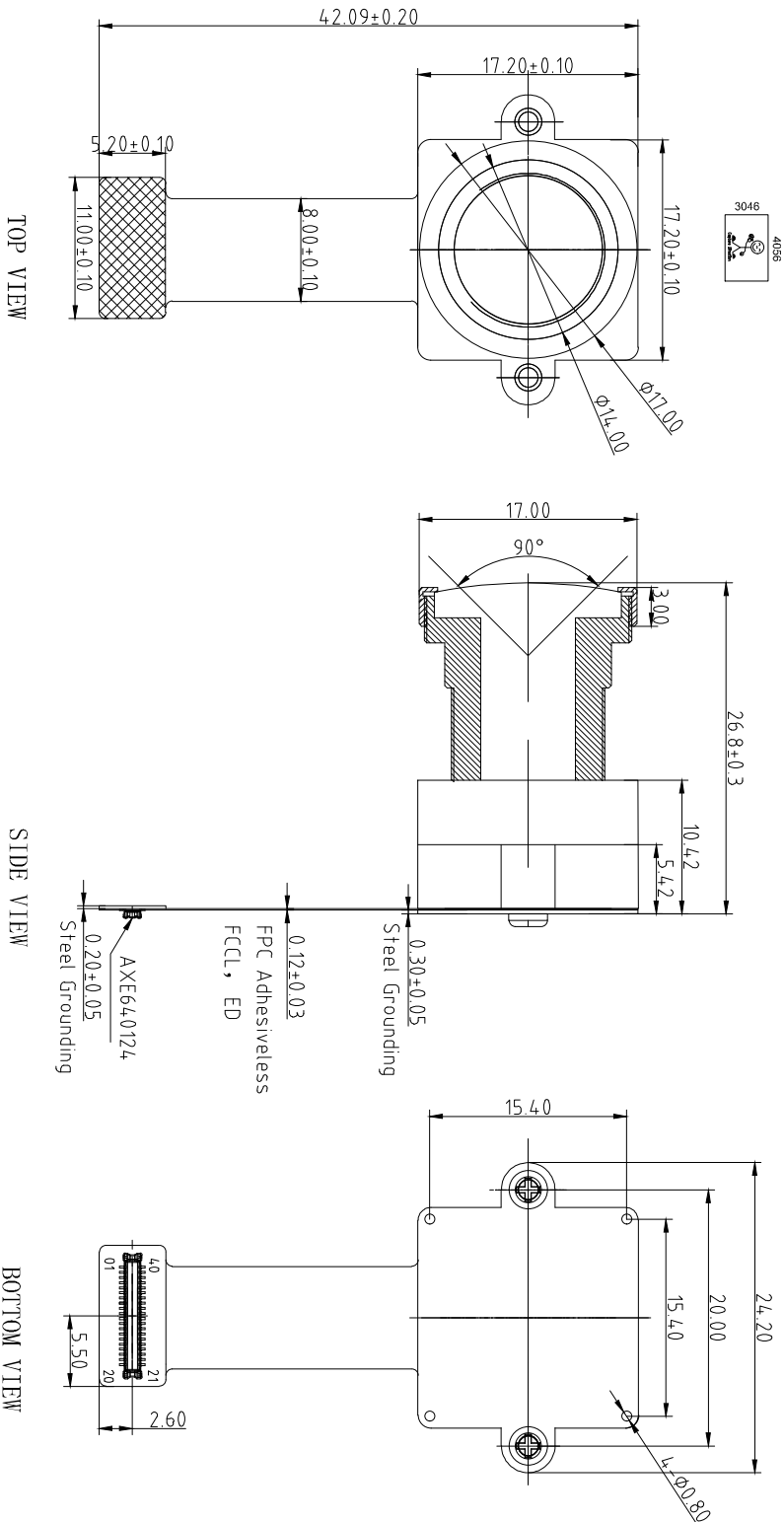
1、Sensor specification:

Image Sensor: IMX377CAT
 Pixel: 1.55um×1.55um
 Lens Type: 1/2.3
 Important Voltage Description: DVDD1.2V
 (External power supply);

2、Lens specification:

FOV: 90° (D) ;77° (H) ;59° (V)
 F/NO.: 2.5
 TV distortion: <2.5%
 Focal length: 4.1mm
 Composition: 5G2P+IR FILTER
 IR Cut Coating: 650nm±10nm@50%

Version Mark		Information		Date
V1.0	PD	First Version		03-09-2020



A

B

C

D

E

3

2

1

3

2

1

Designed By

Kevin

Model Name:

B9MF-IMX377 V1.0

Checked By

Aouly Yan

Projection Type:

Third Angle

Unit:

mm

Material:

Scale:

1:1

Sheet:

1 of 1

Version:

1/0

[Product Information]

IMX377CQT

Ver.1.0

Diagonal 7.81 mm (Type 1/2.3) CMOS Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras

Description

The IMX377CQT is a diagonal 7.81 mm (Type 1/2.3) CMOS image sensor with a color square pixel array and approximately 12.35 M effective pixels. 12-bit digital output makes it possible to output the signals of approximately 12.35 M effective pixels with high definition for shooting still pictures. It also operates with three power supply voltages : analog 2.8 V, digital 1.2 V, and 1.8 V for I/O interface and achieves low power consumption. Furthermore, it realizes 12-bit digital output for shooting high-speed and high-definition moving pictures by horizontal and vertical addition and subsampling. Realizing high-sensitivity, low dark current, this sensor also has an electronic shutter function with variable integration time.

In addition, this product is designed for use in consumer use digital still camera and consumer use camcorder. When using this for another application, Sony Semiconductor Solutions Corporation does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don't use this for applications other than consumer use digital still camera and consumer use camcorder.

In addition, individual specification change cannot be supported because this is a standard product.

Consult your Sony Semiconductor Solutions Corporation sales representative if you have any questions.

Features

- ◆ CMOS active pixel type pixels
- ◆ Input clock frequency 6 to 27 MHz
- ◆ MIPI Specifications (CSI-2 high-speed serial interface)
- ◆ All-pixel scan mode
 - Various readout modes (*)
- ◆ High-sensitivity, low dark current, no smear, excellent anti-blooming characteristics
- ◆ Vertical and horizontal arbitrary cropping function
- ◆ Variable-speed shutter function (minimum unit: 1 horizontal period)
- ◆ Low power consumption
- ◆ H driver, V driver and I²C communication circuit on chip
- ◆ CDS/PGA on chip: Gain +27 dB (step pitch 0.1 dB)
- ◆ 10-bit/12-bit A/D conversion on chip
- ◆ R, G, B primary color mosaic filters on chip
- ◆ All-pixel simultaneous reset supported
- ◆ 98-pin high-precision ceramic package

* Please refer to the datasheet for binning/subsampling details of readout modes.

Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice.
Sony logo is a registered trademark of Sony Corporation.

Device Structure

◆ CMOS image sensor	
◆ Image size	Diagonal 7.81 mm (Type 1/2.3)
◆ Total number of pixels	4152 (H) × 3062 (V) approx. 12.71 M pixels
◆ Number of effective pixels	
- Type 1/2.3 approx. 12.35 M pixels use	4056 (H) × 3046 (V) approx. 12.35 M pixels
- Type 1/2.5 approx. 9.03 M pixels use	4152 (H) × 2174 (V) approx. 9.03 M pixels
◆ Number of active pixels	
- Type 1/2.3 approx. 12.35 M pixels use	4024 (H) × 3036 (V) approx. 12.22 M pixels diagonal 7.81 mm
- Type 1/2.5 approx. 9.03 M pixels use	4120 (H) × 2168 (V) approx. 8.93 M pixels diagonal 7.22 mm
◆ Number of recommended recording pixels	
- Type 1/2.3 approx. 12.35 M pixels use	4000 (H) × 3000 (V) 12.00 M pixels aspect ratio 4:3
- Type 1/2.5 approx. 9.03 M pixels use	4096 (H) × 2160 (V) approx. 8.85 M pixels aspect ratio approx. 17:9
◆ Chip size	10.200 mm (H) × 8.000 mm (V) (include scribe area)
◆ Unit cell size	1.55 μm (H) × 1.55 μm (V)
◆ Optical black	Horizontal (H) direction : Front 0 pixel, rear 0 pixel Vertical (V) direction : Front 16 pixels, rear 0 pixel
◆ Package	98 pin LGA

Image Sensor Characteristics

(T_j = 60 °C)

Item		Value	Remarks
Sensitivity (F5.6)	Typ.	976 digit	1/30 s integration
Saturation signal	Min.	2799 digit	

Basic Drive Mode

Type 1/2.3 Approx. 12.35 M Pixels (4:3)

Drive mode	Number of recording pixels	Max frame rate [frame/s]	Output data bit length [bit]
Readout mode 0	4000 (H) × 3000 (V) 12.00 M pixels	34.97	12
Readout mode 1	4000 (H) × 3000 (V) 12.00 M pixels	39.96	10
Readout mode 1A	4000 (H) × 3000 (V) 12.00 M pixels	29.97	10
Readout mode 2	2000 (H) × 1500 (V) 3.00 M pixels	59.94	12
Readout mode 3	1332 (H) × 998 (V) approx. 1.33 M pixels	59.94	12
Readout mode 4	1332 (H) × 1000 (V) approx. 1.33 M pixels	239.76	12
Readout mode 5	2000 (H) × 750 (V) 1.50 M pixels	239.76	10
Readout mode 6	1332 (H) × 332 (V) approx. 0.44 M pixels	299.70	12
Readout mode 7	1332 (H) × 332 (V) approx. 0.44 M pixels	29.97	12
Readout mode 8	1332 (H) × 174 (V) approx. 0.23 M pixels	659.34	12

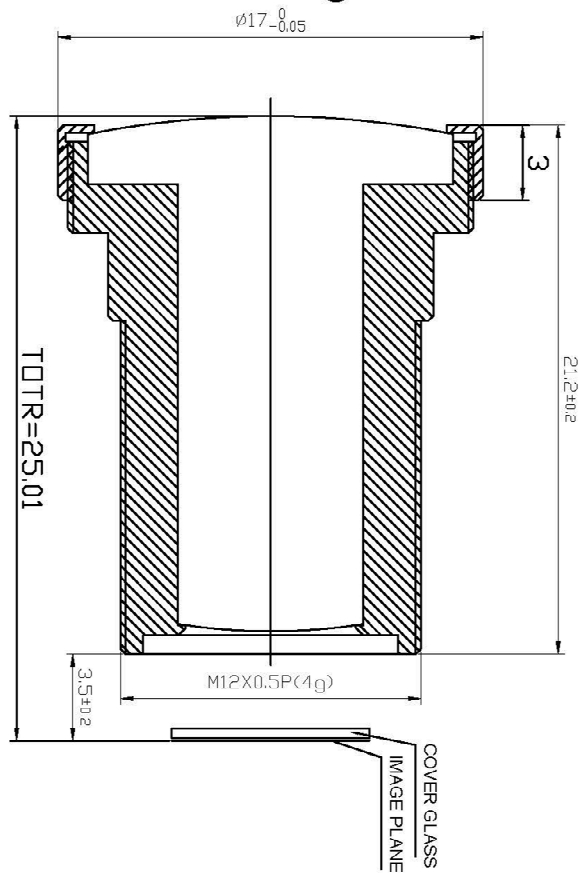
Type 1/2.5 Approx. 9.03 M Pixels (Approx. 17:9)

Drive mode	Number of recording pixels	Max frame rate [frame/s]	Output data bit length [bit]
Readout mode 0	4096 (H) × 2160 (V) approx. 8.85 M pixels	29.97	12
Readout mode 1	3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels	59.94	10
Readout mode 1A	3840 (H) × 2160 (V) approx. 8.29 M pixels	59.94	10
Readout mode 2	2048 (H) × 1080 (V) approx. 2.21 M pixels	119.88	12
Readout mode 2A	2048 (H) × 1080 (V) approx. 2.21 M pixels	119.88	12
Readout mode 3	1364 (H) × 720 (V) approx. 0.98 M pixels	119.88	12
Readout mode 4	1364 (H) × 720 (V) approx. 0.98 M pixels	299.70	12
Readout mode 6	1364 (H) × 240 (V) approx. 0.33 M pixels	419.58	12
Readout mode 8	1364 (H) × 124 (V) approx. 0.17 M pixels	839.16	12

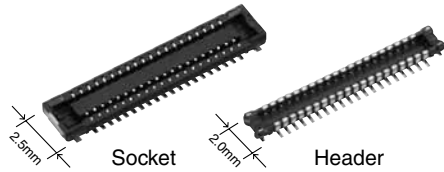
YDS-LENS-MJ7046B

SPECIFICATION

1. FOR 1/2.3" SENSOR
2. IMAGE HEIGHT $\varnothing 8.0$
3. EFL=4.1mm
4. WORKING F/NO.=2.5
5. BFL=5.1mm
6. FOV=90°
H=77°
V=59°
7. DISTORTION=2.5%
8. RELATIVE ILLUMINATION=66%($\gamma=1$)
9. CONSTRUCTION: 5G2P
10. THREAD: M12X0.5P
11. IR FILTER 650±10nm



①	修改记录 REVISION RECORD	姓名 NAME	日期 DATE	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 DRAWING NO.	审核 CHECKED	日期 DATE
②								
③								
④								
⑤								



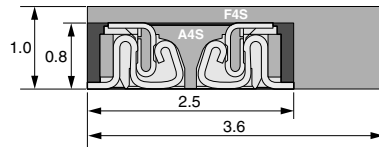
RoHS compliant

FEATURES

1. 2.5 mm wide slim two-piece style connectors

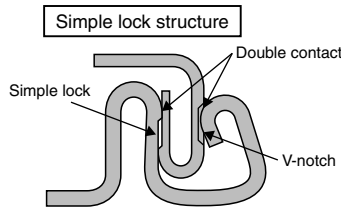
Compact and slim structure contributes overall miniaturization of product design. <Compared to F4S series (40 pin contacts, when mated)>

- Width: 30% down
- Footprint: 30% down



2. “TOUGH CONTACT ADVANCED” ensures high resistance to various environments in lieu of slim and low profile body

3. Simple lock structure provides tactile feedback to ensure excellent mating/unmating operation feel.



The connector gives the tactile feedback when inserted, allowing reliable mating.

- 4. Mated heights of 0.8 and 1.0 mm are available for the same foot pattern.
- 5. Connectors for inspection available

APPLICATIONS

Recommended for board-to-FPC connections of mobile equipment, such as cellular phones, smart phones, laptops, and portable music players

ORDERING INFORMATION

	AXE				2	4
5: Narrow Pitch Connector A4S (0.4 mm pitch) Socket						
6: Narrow Pitch Connector A4S (0.4 mm pitch) Header						
Number of pins (2 digits)						
Mated height						
<Socket>						
1: For mated height 0.8/1.0 mm						
<Header>						
1: For mated height 0.8 mm						
2: For mated height 1.0 mm						
Functions						
2: Without positioning bosses						
Surface treatment (Contact portion / Terminal portion)						
<Socket>						
4: Ni plating on base, Au plating on surface (for Ni barrier available)						
<Header>						
4: Ni plating on base, Au plating on surface						

PRODUCT TYPES

Mated height	Number of pins	Part number		Packing	
		Socket	Header	Inner carton (1-reel)	Outer carton
0.8mm	10	AXE510124	AXE610124	5,000 pieces	10,000 pieces
	12	AXE512124	AXE612124		
	14	AXE514124	AXE614124		
	16	AXE516124	AXE616124		
	18	AXE518124	AXE618124		
	20	AXE520124	AXE620124		
	22	AXE522124	AXE622124		
	24	AXE524124	AXE624124		
	26	AXE526124	AXE626124		
	28	AXE528124	AXE628124		
	30	AXE530124	AXE630124		
	32	AXE532124	AXE632124		
	34	AXE534124	AXE634124		
	36	AXE536124	AXE636124		
	38	AXE538124	AXE638124		
	40	AXE540124	AXE640124		
	44	AXE544124	AXE644124		
	50	AXE550124	AXE650124		
	54	AXE554124	AXE654124		
	1.0mm	56	AXE556124		
60		AXE560124	AXE660124		
64		AXE564124	AXE664124		
70		AXE570124	AXE670124		
80		AXE580124	AXE680124		
10		AXE510124	AXE610224		
12		AXE512124	AXE612224		
14		AXE514124	AXE614224		
20		AXE520124	AXE620224		
24		AXE524124	AXE624224		
26		AXE526124	AXE626224		
30		AXE530124	AXE630224		
32		AXE532124	AXE632224		
40		AXE540124	AXE640224		
44		AXE544124	AXE644224		
50		AXE550124	AXE650224		
54	AXE554124	AXE654224			
60	AXE560124	AXE660224			
70	AXE570124	AXE670224			
80	AXE580124	AXE680224			

Notes: 1. Order unit:

For volume production: 1-inner carton (1-reel) units

Samples for mounting check: 50-connector units. Please contact our sales office.

Samples: Small lot orders are possible. Please contact our sales office.

- The above part numbers are for connectors without positioning bosses, which are standard. When ordering connectors with positioning bosses, please contact our sales office.
- Please contact us for connectors having a number of pins other than those listed above.

AXE5, 6

SPECIFICATIONS

■ Characteristics

	Item	Specifications	Conditions
Electrical characteristics	Rated current	0.3A/pin contact (Max. 5 A at total pin contacts)	
	Rated voltage	60V AC/DC	
	Breakdown voltage	150V AC for 1 min.	No short-circuiting or damage at a detection current of 1 mA when the specified voltage is applied for one minute.
	Insulation resistance	Min. 1,000MΩ (initial)	Using 250V DC megger (applied for 1 min.)
	Contact resistance	Max. 90mΩ	Based on the contact resistance measurement method specified by JIS C 5402.
Mechanical characteristics	Composite insertion force	Max. 1.200N/pin contacts × pin contacts (initial)	
	Composite removal force	Min. 0.165N/pin contacts × pin contacts	
Environmental characteristics	Contact holding force (Socket contact)	Min. 0.20N/pin contacts	Measuring the maximum force. As the contact is axially pull out.
	Ambient temperature	-55°C to +85°C	No freezing at low temperatures. No dew condensation.
	Soldering heat resistance	Peak temperature: 260°C or less (on the surface of the PC board around the connector terminals) 300°C within 5 sec. 350°C within 3 sec.	Infrared reflow soldering Soldering iron
	Storage temperature	-55°C to +85°C (product only) -40°C to +50°C (emboss packing)	No freezing at low temperatures. No dew condensation.
	Thermal shock resistance (header and socket mated)	5 cycles, insulation resistance min. 100MΩ, contact resistance max. 90mΩ	Sequence 1. -55 ^{±3} °C, 30 minutes 2. ~, Max. 5 minutes 3. 85 ^{±3} °C, 30 minutes 4. ~, Max. 5 minutes
	Humidity resistance (header and socket mated)	120 hours, insulation resistance min. 100MΩ, contact resistance max. 90mΩ	Bath temperature 40±2°C, humidity 90 to 95% R.H.
	Saltwater spray resistance (header and socket mated)	24 hours, insulation resistance min. 100MΩ, contact resistance max. 90mΩ	Bath temperature 35±2°C, saltwater concentration 5±1%
H ₂ S resistance (header and socket mated)	48 hours, contact resistance max. 90mΩ	Bath temperature 40±2°C, gas concentration 3±1 ppm, humidity 75 to 80% R.H.	
Lifetime characteristics	Insertion and removal life	30 times	Repeated insertion and removal speed of max. 200 times/hours
Unit weight		20 pin contact type: Socket: 0.02 g Header: 0.01 g	

■ Material and surface treatment

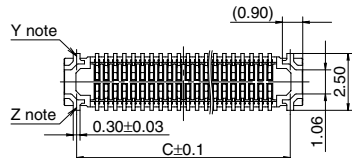
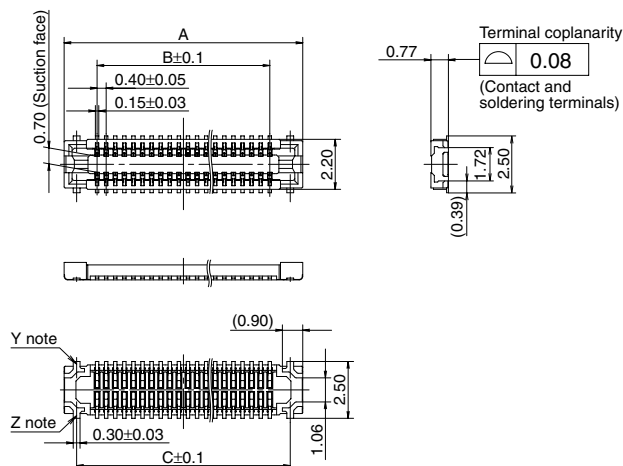
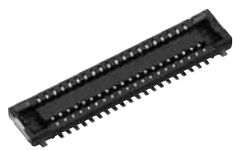
Part name	Material	Surface treatment
Molded portion	LCP resin (UL94V-0)	—
Contact and Post	Copper alloy	Contact portion: Base: Ni plating Surface: Au plating Terminal portion: Base: Ni plating Surface: Au plating (except the terminal tips) The socket terminals close to the portion to be soldered have nickel barriers (exposed nickel portions). Soldering terminals: Sockets: Base: Ni plating Surface: Pd+Au flash plating (except the terminal tips) Headers: Base: Ni plating Surface: Au plating (except the terminal tips)

DIMENSIONS (Unit: mm)

The CAD data of the products with a **CAD Data** mark can be downloaded from: <http://industrial.panasonic.com/ac/e>

Socket (Mated height: 0.8 mm/1.0 mm)

CAD Data



General tolerance: ±0.2

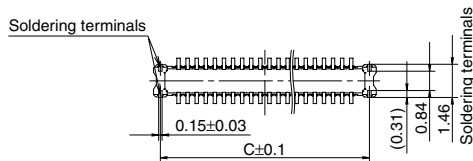
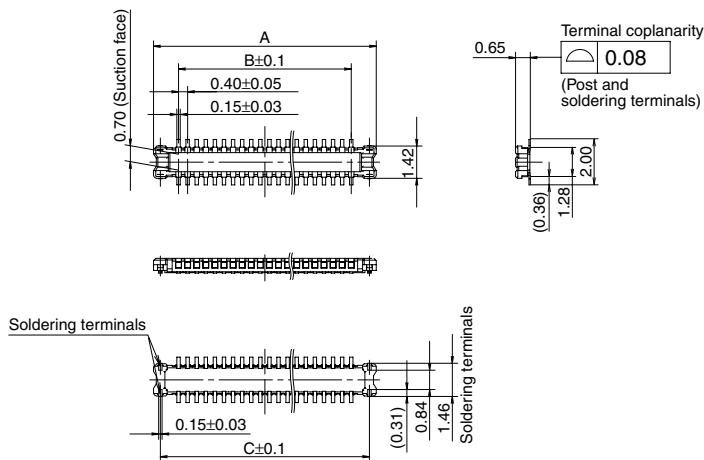
Note: Since the soldering terminals has a single-piece construction, sections Y and Z are electrically connected.

Dimension table (mm)

Number of pins/dimension	A	B	C
10	4.5	1.6	3.4
12	4.9	2.0	3.8
14	5.3	2.4	4.2
16	5.7	2.8	4.6
18	6.1	3.2	5.0
20	6.5	3.6	5.4
22	6.9	4.0	5.8
24	7.3	4.4	6.2
26	7.7	4.8	6.6
28	8.1	5.2	7.0
30	8.5	5.6	7.4
32	8.9	6.0	7.8
34	9.3	6.4	8.2
36	9.7	6.8	8.6
38	10.1	7.2	9.0
40	10.5	7.6	9.4
44	11.3	8.4	10.2
50	12.5	9.6	11.4
54	13.3	10.4	12.2
56	13.7	10.8	12.6
60	14.5	11.6	13.4
64	15.3	12.4	14.2
70	16.5	13.6	15.4
80	18.5	15.6	17.4

Header (Mated height: 0.8 mm)

CAD Data



General tolerance: ±0.2

Dimension table (mm)

Number of pins/dimension	A	B	C
10	3.8	1.6	3.2
12	4.2	2.0	3.6
14	4.6	2.4	4.0
16	5.0	2.8	4.4
18	5.4	3.2	4.8
20	5.8	3.6	5.2
22	6.2	4.0	5.6
24	6.6	4.4	6.0
26	7.0	4.8	6.4
28	7.4	5.2	6.8
30	7.8	5.6	7.2
32	8.2	6.0	7.6
34	8.6	6.4	8.0
36	9.0	6.8	8.4
38	9.4	7.2	8.8
40	9.8	7.6	9.2
44	10.6	8.4	10.0
50	11.8	9.6	11.2
54	12.6	10.4	12.0
56	13.0	10.8	12.4
60	13.8	11.6	13.2
64	14.6	12.4	14.0
70	15.8	13.6	15.2
80	17.8	15.6	17.2

Kameraanwendungen



Autopilot



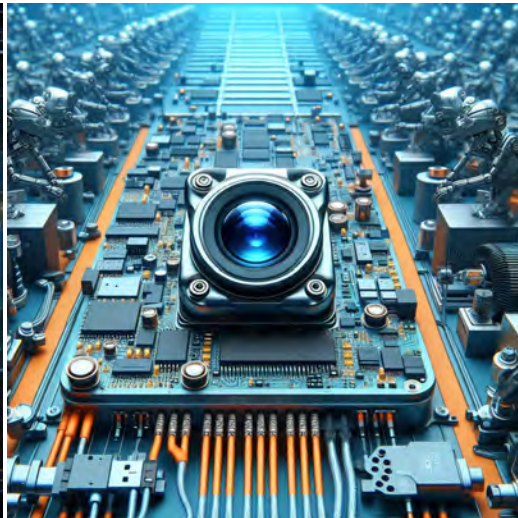
Live-Streaming



Videokonferenz



Biometrische Eye-Tracker-Erkennung



Maschinelles Sehen



Agrarmonitor



Nachtsichtsicherheit



Drohnen- und Sport-Adleraugen



Interaktive Haustierkamera

Referenztable für die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren	
Pin Signal	Beschreibung
DGND GND	Masse für digitale Schaltung
AGND	Masse für analoge Schaltung
PCLK DCK	DVP-PCLK-Ausgang
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand
MCLK XVCLK XCLK INCK	Systemeingangsuhr
RESET RST	Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zurücksetzen
NC NULL	keine Verbindung
SDA SIO_D SIOD	SCCB-Daten
SCL SIO_C SOIC	SCCB-Eingangstakt
VSYNC XVS FSYNC	DVP-VSYNC-Ausgang
HREF XHS	DVP-HREF-Ausgang
DOVDD	Strom für E/A-Schaltung
AFVDD	Strom für VCM-Schaltung
AVDD	Strom für analoge Schaltung
DVDD	Strom für digitale Schaltung
STROBE FSTROBE	Strobe-Ausgang
FSIN	Synchronisieren Sie das VSYNC-Signal vom anderen Sensor
SID	SCCB letzte Bit-ID-Eingabe
ILPWM	mechanische Shutter-Ausgangsanzeige
FREX	Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss
GPIO	Allzweckeingänge
SLASEL	I2C-Slave-Adresse auswählen
AFEN	CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC
MIPI Schnittstelle	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur
MCN CLKN CLK_N DCKN	MIPI Uhr negativer Ausgang
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	MIPI Takt positiver Ausgang
DVP Parallel Schnittstelle	
D0 DO0 Y0	DVP Datenausgabeport 0
D1 DO1 Y1	DVP Datenausgabeport 1
D2 DO2 Y2	DVP Datenausgabeport 2
D3 DO3 Y3	DVP Datenausgabeport 3
D4 DO4 Y4	DVP Datenausgabeport 4
D5 DO5 Y5	DVP Datenausgabeport 5
D6 DO6 Y6	DVP Datenausgabeport 6
D7 DO7 Y7	DVP Datenausgabeport 7
D8 DO8 Y8	DVP Datenausgabeport 8
D9 DO9 Y9	DVP Datenausgabeport 9
D10 DO10 Y10	DVP Datenausgabeport 10
D11 DO11 Y11	DVP Datenausgabeport 11

Kamera-Zuverlässigkeitstest

Zuverlässigkeitsprüfpunkt		Testmethode	Akzeptanzkriterium	
Kategorie	Artikel			
Umwelt	Lager Temperatur	Hoch 60°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 96 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Betriebs Temperatur	Hoch 60°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
		Niedrig -20°C 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Feuchtigkeit	60°C 80% 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
	Thermischer Schock	Hoch 60°C 0.5 Std Niedrig -20°C 0.5 Std Radfahren rein 24 Std	Temperaturkammer	Keine anormale Situation
Physisch	Falltest (Im freien Fall)	Ohne Verpackung 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
		Mit Paket 60cm	10 Mal auf Holzboden	Elektrisch funktionsfähig
	Vibrations Test	50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
		50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten	Vibrationstisch	Elektrisch funktionsfähig
	Zugfestigkeit des Kabels Krafttest	Gewicht laden 4 kg 60 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Zugprüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
Elektrisch	ESD-Test	Kontaktaufnahme 2 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
		Luftentladung 4 KV	ESD-Prüfmaschine	Elektrisch funktionsfähig
	Alterungstest	On/Off 30 Sekunden Radfahren rein 24 Std	Stromschalter	Elektrisch funktionsfähig
	USB-Anschluss	On/Off 250 Mal	Einstecken und ausstecken	Elektrisch funktionsfähig



Kamerainspektionsstandard

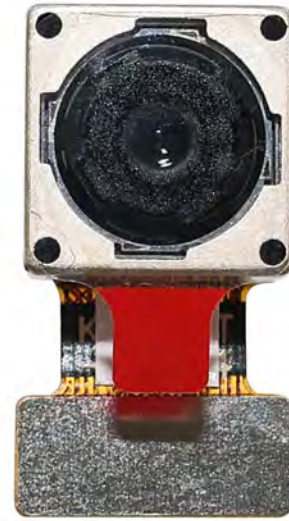
Inspektionsgegenstand		Untersuchungsmethode	Inspektionsstandard	
Kategorie	Artikel			
Aussehen	FPC oder PCB	Farbe	Das bloße Auge	Größere Unterschiede sind nicht zulässig.
		Zerrissen/gehackt werden	Das bloße Auge	Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zulässig.
		Markierung	Das bloße Auge	Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)
	Halterin	Kratzer	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
		Lücke	Das bloße Auge	Erfüllen Sie den Höhenstandard
		Schraube	Das bloße Auge	Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)
		Schaden	Das bloße Auge	Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulässig
	Linse	Kratzen	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Kontamination	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Ölfilm	Das bloße Auge	Keine Auswirkung auf den Auflösungsstandard
		Abdeckband	Das bloße Auge	Kein Problem beim Aussehen.
	Funktion	Bild	Keine Kommunikation	Testboard
Helles Pixel			Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Dunkles Pixel			Weißer Tafel	Im Image Center nicht erlaubt
Verschwommen			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kein Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Vertikale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Horizontale Linie			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Kleines Leck			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Blinkendes Bild			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Prellung			Inspektionslehre	Nicht erlaubt
Auflösung			Diagramm	Folgt dem Diagrammstandard für ausgehende Inspektionen
Farbe			Das bloße Auge	Kein Problem
Lärm			Das bloße Auge	Nicht erlaubt
Ecke dunkel			Das bloße Auge	Weniger als 100 x 100 Pixel
Farbauflösung			Das bloße Auge	Kein Problem
Abmessungen	Höhe	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Breite	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Länge	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	
	Gesamt	Das bloße Auge	Befolgt Zulassungsdatenblatt	

YDSCAM Paketlösungen

YDSCAM Kameramodul



Komplett mit Linsenschutzfolie



Tablett mit Gitter und Raum



Legen Sie die Kameras auf das Tablett

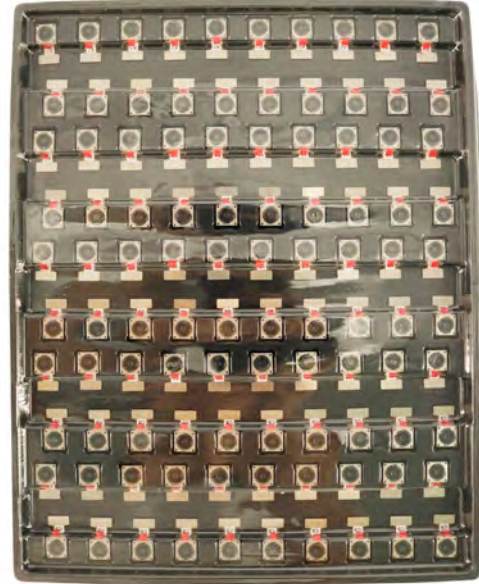


YDSCAM Paketlösungen

Volles Fach mit Kameras



Decken Sie das Tablett mit dem Deckel ab



Legen Sie das Tablett in den antistatischen Beutel



Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel



YDSCAM Paketlösungen

Versiegelter antistatischer Vakuumbbeutel mit Etiketten

1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Herstellungsdatumscode 4. Achtung



YDSCAM Paketlösungen

Legen Sie Schaumstoffplatten zwischen die Tablettbeutel



Schaumstoffplatten sind größer als Tablettbeutels



Legen Sie Schaumstoffplatten und Tablettbeutels in den Karton



Die Schaumstoffplatten sitzen fest im Karton



Verschließen Sie die Carbon Box



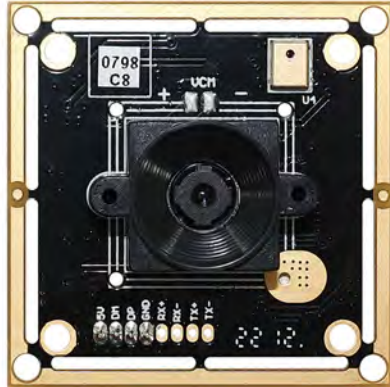
Beschriften Sie den Carbon-Versandkarton



YDSCAM Paketlösungen

USB-Kameramodul

Komplett mit Objektivschutzfolie



Legen Sie die Kameraprobe in den antistatischen Beutel

Legen Sie USB-Kameras in das Fach



Verschließen Sie das Tablett mit einem antistatischen Beutel

Beschriften Sie den Carbon-Versandkarton



YDSCAM Paketlösungen

Legen Sie die Kameraprobe in den antistatischen Beutel



Legen Sie die Steckverbinder in den antistatischen Beutel



Beschriften Sie die Probenbeutel



Stecken Sie die Steckverbinder in die Spule



Legen Sie Proben in die Carbonbox



Stecken Sie die Steckverbinder in die Carbonbox



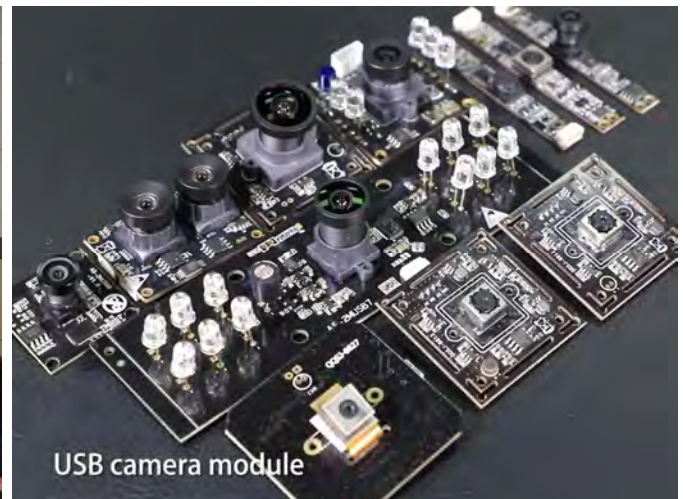


Firma YDSCAM

YingDeShun Co. Ltd. (YDS) wurde 2017 gegründet, ein technologieorientierter Hersteller der nächsten Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. YDS verfügt über 20.000 Quadratmeter große automatisierte Anlagen mit 100 Mitarbeitern und einem Jahresdurchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

YDS bietet OEM- und ODM-Design sowie Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie können uns die Anforderungen mitteilen, sogar mit einem Handentwurf. Unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lösungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. YDS ist auf kundenspezifisches Kameradesign, Rohmaterial, Elektroniktechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkttests und Verpackungsdesign spezialisiert. Unsere erfahrenen strategischen Liefersysteme bieten eine robuste und zuverlässige Fertigungskapazität für Aufträge unterschiedlicher Größe.



Eingeschränkte Garantie

YDS gewährt die folgende eingeschränkte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der YDS-Firma oder über die YDS-Website www.YDSCAM.com erworben haben. Von anderen Verkäufern oder Quellen gekaufte Produkte fallen nicht unter diese eingeschränkte Garantie. YDS garantiert, dass die Produkte bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten („Garanzzeitraum“), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Für alle Produkte, die während der Garanzzeit wesentliche Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen oder entwickeln, wird YDS nach eigenem Ermessen entweder: (i) das/die Produkt(e) reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein/e neue oder generalüberholte(n) Produkt(e) ersetzen (wobei das/die Ersatzprodukt(e) vom identischen Modell oder einer gleichwertigen Funktion sein müssen); oder (iii) Ihnen eine Rückerstattung des Preises gewähren, den Sie für das/die Produkt(e) bezahlt haben.

Diese eingeschränkte Garantie von YDS beschränkt sich ausschließlich auf Reparatur und/oder Ersatz gemäß den oben dargelegten Bedingungen. YDS ist nicht zuverlässig oder verantwortlich für etwaige Folgeereignisse.





YDS CAMERA MODULE

your best camera partner

Unsere Unternehmensstärke

Leistungsstarke Fabrik



Professioneller Service



Versprochene Lieferung



www.YDSCAM.com sales@ydscam.com Phone (WeChat, QQ): (+86) 177 2732 6718

All rights reserved @ YingDeShun Co. Ltd. Specifications subject to change without notice.